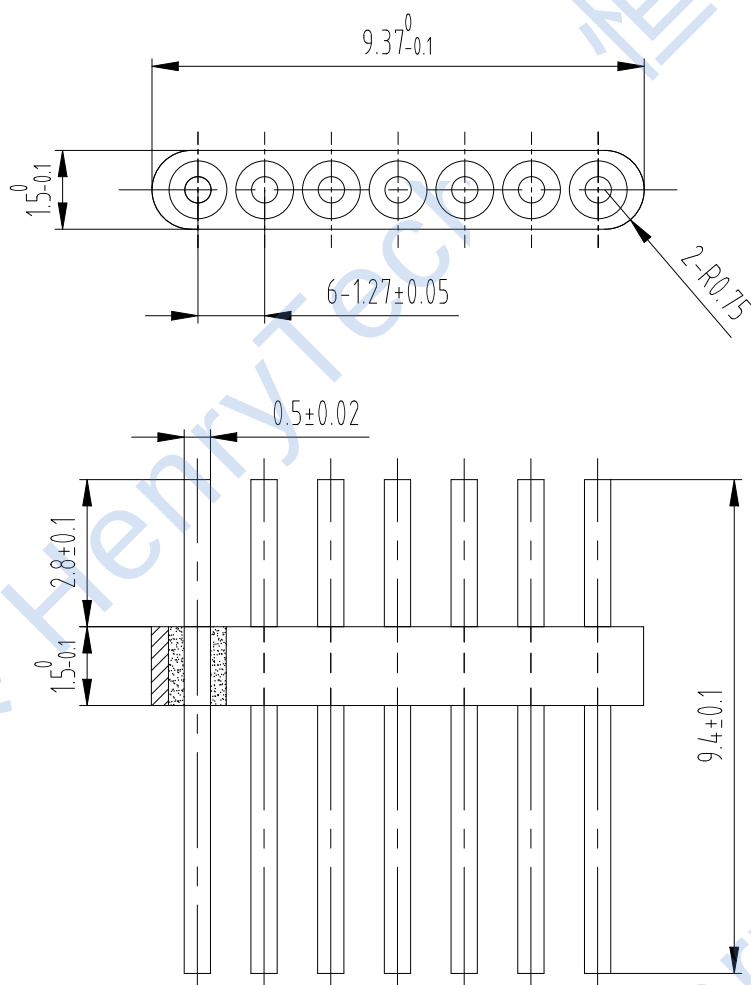




借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

技术要求：

1. 绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega @ 500V$
2. 介电耐压： $\geq 300V$
3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/S$
4. 使用寿命： $\geq 500$ 次
5. 温度范围： $-65 \sim +155$
6. 镀层厚度： $\geq 1.27 \mu m$ 软金

签 字

日 期

装配图

HN-LP7-0.5-1.27(9.4-2.8)

成都恒利泰科技有限公司

成都恒利泰科技有限公司  
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

|    |    |       |     |    |  |      |  |  |     |  |     |  |
|----|----|-------|-----|----|--|------|--|--|-----|--|-----|--|
|    |    |       |     |    |  | 图样标记 |  |  | 重量  |  | 比例  |  |
|    |    |       |     |    |  |      |  |  |     |  |     |  |
|    |    |       |     |    |  |      |  |  |     |  |     |  |
|    |    |       |     |    |  |      |  |  |     |  |     |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字  | 日期 |  |      |  |  |     |  | 7:1 |  |
| 设计 | M  |       | 标准化 |    |  |      |  |  |     |  |     |  |
| 审核 |    |       |     |    |  |      |  |  |     |  |     |  |
| 工艺 |    |       | 日期  |    |  | 共 页  |  |  | 第 页 |  |     |  |